

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2023-0410-014

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>网络会议</u>
参与单位名称	香港商野村国际证券有限公司 财通证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 因投资者关系活动中香港商野村国际证券有限公司采取网络会议形式，参会者未签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间	2023年4月10日 11:00-11:30 网络会议 香港商野村国际证券有限公司 2023年4月10日 14:30-15:30 实地调研 财通证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司
地点	公司会议室
公司接待人员	证券事务代表：钱元君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍了公司2022年业绩情况</p> <p>2022年Q4随着供应链短缺和资源限制等因素的改善，企业通讯市场板市场客户提货相对加速，2022年Q4公司实现营业收入约25.72亿，环比增长约26.85%，同比增长约28.17%。从全年看，受益于交换机、路由器、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板（下称“PCB”）的结构性需求以及汽车行业在电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化的驱动下，对ADAS(高级驾驶辅助系统)、智能座舱、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域中高端PCB的持续需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2022年公司实现营业收入约83.36亿元，其中PCB业务实现营业收入约79.31亿元，同比增长约12.36%；同时随着PCB业务产品结构的进一步优化，2022年PCB业务毛利率提升至约31.72%，同比增加约3.22个百分点；2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润约13.62亿元，同比增长约28.03%。</p>

二、行业情况

2022年PCB市场整体新增需求在第四季度开始明显疲软，Prismark预估2022年第四季度PCB市场环比下降约7.7%，同比下降约14.6%，因此相应将其对2022年PCB市场增长预期从2.9%下修至1.0%，2022年全球PCB产值约为817.41亿美元。出于对全球通货膨胀和经济衰退等因素的担忧，面对全球经济前景疲软，展望2023年PCB行业或将面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，多重因素的冲击恐将大幅抑制2023年上半年PCB行业的新增需求，直到2023年底和2024年的经济形势复苏。Prismark预估2023年全球PCB产值同比将下滑4.13%。

但从中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势，Prismark预测2022-2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%，2027年全球PCB产值将达到约983.88亿美元。中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2022-2027年中国PCB产值复合增长率约为3.3%，略低于全球，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元

(1) 企业通讯市场板业务情况

全球经济增长预期放缓以及通胀压力引发了对企业通讯市场需求水平的可持续性的担忧，促使客户开始缩减先前因避免缺料等风险普遍建立的过高库存。随着美联储的加息周期推进，企业通讯市场趋向保守，新增订单疲软。经济环境的不确定性提高，将会进一步加剧企业通讯市场的需求波动。

从中长期看，全球范围内大型云服务和互联网厂商对数据中心基础设施的投资不会停滞，云计算、大数据、超高清视频、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用和发展将促使全球数字化转型，并进一步放大了网络的重要性，加快了数字化转型的进程。这将加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品也有望高速成长，催生对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB产品的强劲需求，并对其技术层次和品质提出更高的要求。

公司也将坚持以技术创新和产品升级为内核，持续加大在技术和创新方面的投资，通过深度参与客户产品的预研和开发，准确把握未来的产品与技术方向，进行新技术新工艺的研发，储备关键核心技术，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。

	<p style="text-align: center;">(2) 汽车板业务情况</p> <p>在汽车电子趋势变化的驱动下，2023年全球汽车市场预计仍将继续呈现稳中向好的发展态势，相关产品的结构性需求也有望呈现出显著的增长潜力。2023年初公司使用自有资金向沪利微电增资约7.76亿人民币，沪利微电将有针对性地加速投资，有效扩充汽车高阶HDI产能。此外，出于对混合动力、纯电动汽车驱动系统等方面PCB技术面临的问题、发展趋势以及p²Pack技术前景的判断，公司于2022年初投资参股胜伟策，并于2022年末与Schweizer、胜伟策签署了《股权转让协议》，后续该交易如经批准完成，胜伟策将成为公司的控股子公司，公司将加快p²Pack技术开发与市场推广。一方面尽快完成胜伟策应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证，争取在2023年第四季度实现量产；另一方面通过和产业链合作伙伴的深度合作，加快推进应用于800V高压架构的产品技术优化和转移，推动采用p²Pack技术的产品在纯电动汽车驱动系统等方面的商业化应用。在p²Pack技术开发与市场推广期间，全面推进胜伟策与公司在汽车应用领域的核心业务协同整合，采取有效措施改善其财务结构，降低其利息负担；实施精益管理，使其达成降本增效；借助公司、Schweizer、胜伟策在汽车应用领域的优势技术能力，优化市场布局，以充分利用胜伟策现有产能，最大幅度的缩减胜伟策亏损额。</p> <p style="text-align: center;">三、海外基地进展情况</p> <p>由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键，公司已购买位于泰国洛加纳大城工业园区内的面积约201,846.8平方米的土地，以满足公司泰国子公司未来项目建设需求。公司将加速泰国生产基地的进程，并已启动基建，力争将其实现规模量产的规划，从2025年上半年提前到2024年第四季度。</p> <p style="text-align: center;">注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023年4月10日